



平成 18年 3月期 中間決算短信(連結)

平成 17年 11月 11日

上場会社名



株式会社東京精密

上場取引所 東

コード番号

7729

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.accretech.jp/>)

代表者 代表取締役社長 C.E.O.兼 C.O.O. 鈴木 貞勝

問合せ先責任者 代表取締役業務会社執行役員社長 太田 邦正

TEL (0422) 48 - 1011

中間決算取締役会開催日 平成 17年 11月 11日

米国会計基準採用の有無 無

1. 17年 9月中間期の連結業績(平成 17年 4月 1日 ~ 平成 17年 9月 30日)

(1)連結経営成績

(百万円未満は切捨表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年 9月中間期	42,083	7.2	6,593	19.2	6,720	19.0
16年 9月中間期	45,340	75.0	8,157	506.2	8,295	728.5
17年 3月期	84,750		13,051		12,885	

	中間(当期)純利益		1株当たり 中間(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
17年 9月中間期	3,914	12.1	104	39	95	28
16年 9月中間期	4,454	-	119	07	108	95
17年 3月期	4,459		118	82	108	75

(注) 持分法投資損益 17年 9月中間期 - 百万円 16年 9月中間期 - 百万円 17年 3月期 - 百万円
 期中平均株式数(連結) 17年 9月中間期 37,495,268 株 16年 9月中間期 37,408,547 株 17年 3月期 37,452,407 株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
17年 9月中間期	104,436	36,755	35.2	980	29
16年 9月中間期	98,311	33,530	34.1	894	21
17年 3月期	100,993	33,003	32.7	879	93

(注) 期末発行済株式数(連結) 17年 9月中間期 37,494,533 株 16年 9月中間期 37,497,268 株 17年 3月期 37,495,725 株

(3)連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年 9月中間期	1,108	4,622	2,365	10,737
16年 9月中間期	5,554	857	6,847	10,149
17年 3月期	7,058	1,769	5,732	11,838

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 8 社 持分法適用非連結子会社数 0 社 持分法適用関連会社数 0 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規)0 社 (除外)0 社 持分法(新規)0 社 (除外)0 社

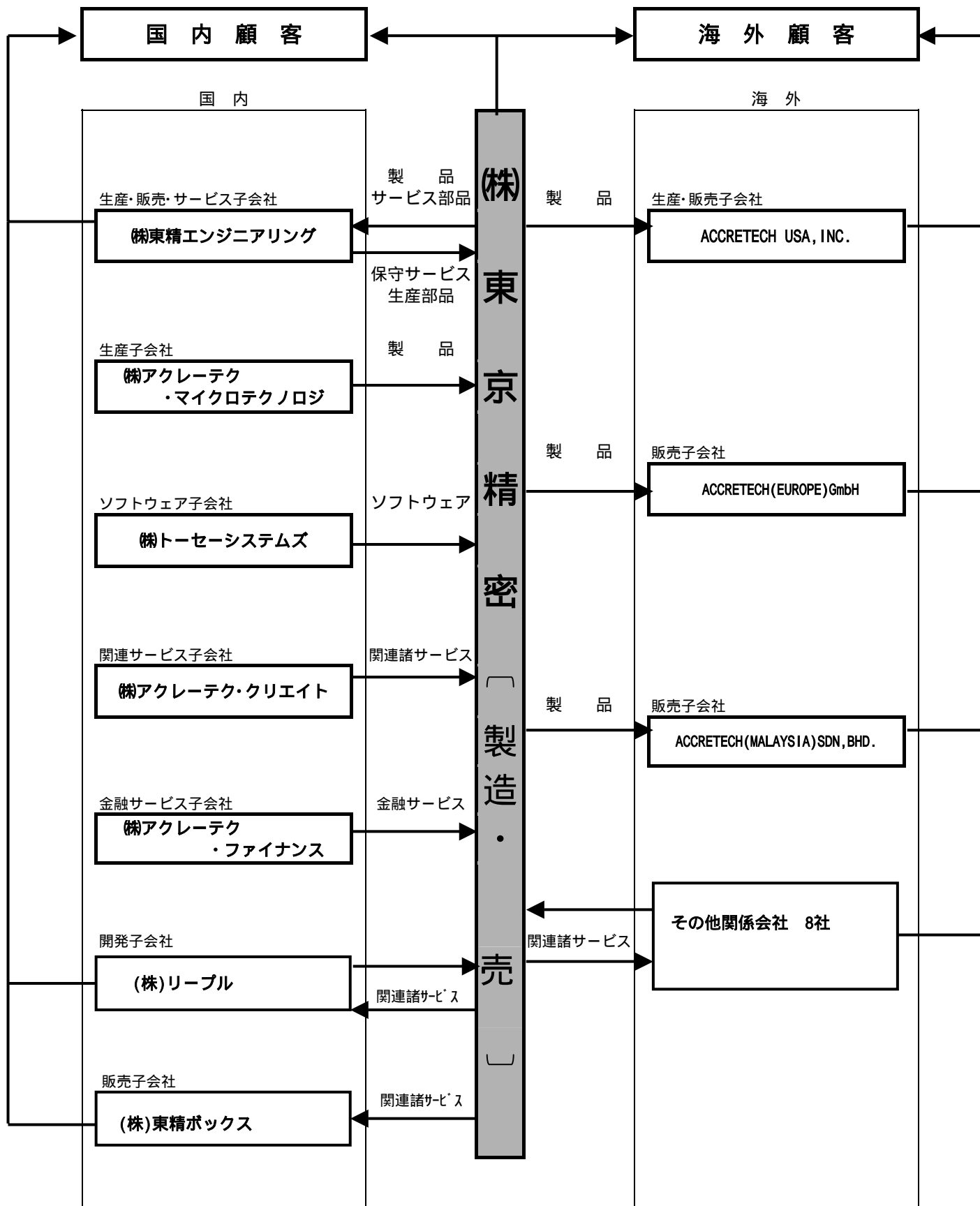
2. 18年 3月期の連結業績予想(平成 17年 4月 1日 ~ 平成 18年 3月 31日)

通期	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
	89,000	14,000	7,700

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 200 円 78 銭

上記の予想は、添付資料8,9ページの通期の見通しを前提としております。

1. 企業集団の状況



2 . 経営方針

(1) 基本方針

当社は、精密計測機器及び半導体製造用機器メーカーとして、常にお客様の高生産性に寄与する最先端技術を駆使した製品開発とカスタマーサポートに注力してまいりました。技術革新が高レベルかつ高スピードで進行する環境下、当社が発展し続けるために最も重要な事は、強い製品開発体制と適正な製品開発基準を持つことです。そこで、以下に掲げる「製品開発の原則」を当社の経営の大原則として、市場の設備投資動向の影響を最小限に抑えつつ、高成長・高収益のビジネス基盤を構築し、さらなる企業価値向上に努めております。

「製品開発の原則」

世界 No.1 の製品を創る

マーケットシェア No.1 の商品は、

(a) 好況時の利益の極大化がはかれる

(b) 不況時の損失の極小化がはかれる

研究開発投資は自己資金で

技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う

相応しいパートナーを見つけ、開発コストをシェアするとともに開発の成果を共有する

また、「WIN - WIN の仕事で世界 No.1 の商品を創ろう」を当社の行動指針として制定し、「製品開発の原則」遵守を徹底して推進しております。世界 No.1 の製品開発には、各分野における最先端の技術とスピードが要求されます。そのためには、当社の培ってきたコア・テクノロジーを応用することに加え、国内外の垣根を越えて、世界 No.1 の製品創りという共通目的をもつ会社および個人と“WIN - WIN”の協力関係を築くことが不可欠です。各国、各社のもつ異文化を融合したグローバルかつハイブリッドな社風を醸成することにより、世界 No.1 の製品開発体制を構築して、真のグローバル・カンパニーとなるべく努力しております。

当社のコーポレートブランド「ACCRETECH (アクレーテック)」は、「ACCRETE (= Grow Together の意味) + TECHNOLOGY」の合成語で、世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界 No.1 の商品を創り、皆様とともに大きく成長していくという当社の企業理念を一語で表わしたものです。

(2) ユニークな開発体制

当社は、1988 年より各技術開発グループを製品群別に分け、グループリーダーをヘッドとするグループリーダー制を採用しています。グループリーダーは、製品開発のみならず、担当する製品群の業績全般についての責任をもち、事業計画作成、設備投資及び人材の採用など大きな権限を与えられています。

2002 年 4 月、当社の執行役員制導入に伴い、グループリーダーは、執行役員に選任されました。これにより、グループリーダー制の備えている、開発計画などのスピーディな意思決定や市場動向への迅速・柔軟な対応という長所が一層強化されました。

(3) 利益配分に関する基本方針

当社は、成長分野において、最先端技術を駆使した世界 No.1 商品を提供することにより、企業価値を高め、株主の皆様へ利益還元を図ってまいりたいと考えております。配当につきましては、将来の事業展開のための企業体質強化に配慮の上、株主の皆様の長期的視点を重視しつつ、連結当期純利益に対する配当性向 20%を目途に実施していく考えです。

内部留保金につきましては、当社が成長していくために不可欠な研究開発投資、生産設備投資などに有効に活用してまいりたいと存じます。

(4) 目標とする経営指標

当社は、株主の皆様が当社株式を所有する目的に沿った経営を行っております。従って、一株当たり利益の長期的な上昇とその結果としての企業価値の長期的な上昇を、経営上の重要な指標と考えています。

(5) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、前記の開発の原則に基づき、「ウェーハ外観検査装置」・「ポリッシュ・グライнда」・「CMP 装置」など、技術参入障壁が高く、マーケットも大きい、高機能・高価格の半導体新規参入製品を開発してきました。

「ウェーハ外観検査装置」・「ポリッシュ・グライнда」は 2000 年度に、「CMP 装置」は 2002 年度に夫々市場投入し、ビジネスとして順調に成長し、これら半導体新規参入製品の当中間期の売上高は 96 億円と前中間期比 35%増となりました。今後も新規参入製品の売上は着実に拡大し、数年後には半導体売上の半分程度を占めるとともに利益率も上昇していく見込です。

一方、生産に関しては、当社は 2005 年 3 月に土浦工場と八王子工場に、計測および半導体夫々の新工場を完成させました。当社は両新工場の稼働を機に、より一層生産改革に取り組み、品質の向上とコストダウンを推進しております。

当社は、今後新規参入製品を中心として、売上の拡大と利益率の上昇を図ってまいります。早期に売上高 1,000 億円を実現し、当社の創業 60 周年に当たる 2009 年 3 月期には、1000 億円を大きく上回る売上高と営業利益率 25%の確保を目指し、企業価値の増大に努めます。

当社は、この 9 月に「長期戦略チ - ム」を発足させました。当社のお客様の業界は、長期的に見ると、半導体の微細化の限界や自動車の内燃機関から電気モ - タ - への移行など、大きな変質や新しい技術分野の拡大が予想されます。

「長期戦略チ - ム」は、C.T.O.を中心に組織横断的なメンバ - で構成され、長期的な視野から、大きな変質や新しい技術分野に対応する新規事業のシ - ズについて、調査研究をすすめます。

(6) 会社の対処すべき課題

新製品事業の成功

当社は、ここ数年来、半導体新規参入製品の開発を積極的に進めてきた結果、「ポリッシュ・グライнда」は、デファクトスタンダードとして 100%に近いマーケットシェアを有する大ヒット製品となり、計画通りの利益率を上げています。また、「ウェーハ外観検査装置」も、予定通りマーケットシェアを拡大しておりますし、「CMP 装置」につきましても顧客開拓が進んでいます。これら新規参入製品の合算売上高は、計測部門を上回る規模となっております。

今後は、新規参入製品の販売をさらに伸ばすとともに、コストダウンにも注力し、「ウェーハ外観検査装置」と「CMP 装置」の利益率についても計画ラインまで向上させていくことが肝要です。

財務構成の改善

当社の自己資本比率や資産回転率などの財務諸比率は、当中間期の業績好調により、着実に改善することができましたが、財務構成についてさらなる改善が必要だと考えています。今後中期的には、売上・利益の拡大によるフリーキャッシュフローのプラスと転換社債型新株予約権付社債の資本への転換により、財務諸比率は格段に良くなる見通しです。

(7) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とその施策の実施状況

<コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方>

経済のグローバル化が進み企業の経営環境が目覚ましい変化を遂げる中、持続的な成長を実現するには、その変化のスピードに対応できる経営体制の構築と、経営の国際標準化および株主重視経営に適合したコーポレートガバナンスの充実が不可欠と認識しております。

株主の権利の保護と平等な扱いに留意するとともに、他のステークホルダーとの円滑な関係の構築にも努めております。今後とも、適切な情報開示と透明性確保を図り、取締役会と監査役会の機能発揮によるコーポレートガバナンスの実効性確保に注力してまいります。

<コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況>

執行役員制とカンパニー制の導入

当社は、2002年4月に執行役員制と社内カンパニー制を導入し、社内を半導体社、計測社、業務会社の3つのカンパニーに分けました。全てのオペレーションは、この3社で行うこととし、head office としての機能は廃止いたしました。

半導体社と計測社は、完結した組織として、夫々のお客様に一層機動的かつ迅速に対応できるように、業務会社は、間接部門の合理化を推進しております。

コーポレートガバナンスの実効性確保

A．取締役会は、会社の重要な業務執行について決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督する機関ですが、当社の取締役は出身企業が多岐にわたる取締役に構成されたハイブリッドな組織となっています。

東京精密は、社内カンパニー制の導入により理論的には取締役会のみとなり、執行を各カンパニーに委嘱しています。

B．当社は監査役制度を採用しております。当社の監査役は、当社の大株主出身の経営者と有識者で構成されており、現在4名のうち3名が社外監査役であります。当社の監査役は、報酬委員会および経営諮問委員会のメンバーを兼務し、役員の報酬その他、経営の妥当性の判断も行っています。

C．以上のように当社の取締役会および監査役会のシステムは、日本、米国、ドイツのコーポレートガバナンスの長所をミックスした制度になっています。従って、当社のコーポレートガバナンスは、極めて透明性が高く、accountability が明確であります。

内部統制システム、リスク管理体制および内部監査の状況

当社は、株主、お客様、お取引先、従業員などすべてのステークホルダーとWIN-WINの関係を創りあげ、長期的に成長していくためには、社会に受け入れられる行動が不可欠であると考えています。当社は透明性の高い清潔な企業姿勢を保つため、「コンプライアンス委員会」が中心となり、「ACCRETECH グループ行動規範」を定め、企業倫理の徹底と、コンプライアンス体制の強化に努めるとともに、毎年「環境・社会報告書」を作成し、当社の環境理念と社会的責任についての考え方を説明しています。

また、「人事相談室」を設置し、従業員にかかわる人権や健康などのリスク管理に注力する一方、「情報セキュリティ委員会」の定めた「秘密情報管理方針」に基づき、秘密情報の管理と技術情報の流出防止にも努力しています。

内部監査部門である監査室は、監査役、監査法人および輸出管理業務室などと連携をとりながら、日常的に業務監査を行い、問題点の把握や改善勧告を行っています。

(8) 親会社等に関する事項

当社は、当期末現在親会社等を有していません。

(9) 株式会社東精エンジニアリングの完全子会社化

当社と東精エンジニアリングは、2005年5月6日開催のそれぞれの取締役会において、株式交換により、東精エンジニアリングを当社の完全子会社（100%子会社）とすることを決議し、株式交換契約を締結いたしました。

お客様の高精度・高生産性へのニーズに的確に対応し、最先端技術の世界 No.1 の製品を開発していくためには、両社が一体化し、より一層連携を図り、従来以上に迅速かつ機動的な事業運営を行う必要があると考え、完全子会社化したものです。

商法に定められた所定の手続を経て、2005年10月1日を株式交換の日として、東精エンジニアリングの株式1株に対して、東京精密の株式0.51株を割当交付いたしました。

3 . 経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

当中間期の概況

[業績全般]

年初、当中間期の半導体業界は、軽微な調整局面と予想されていましたが、パソコン・携帯電話の好調やデジタル家電の堅調により、半導体メーカーの設備投資は根強く、製造装置に対する需要も伸長しています。

これを反映して、当社半導体製造装置部門の市況も好転し、過去最高であった前中間期比では減少となりましたが、前年度下期対比では大幅な増収・増益となりました。

計測機器部門につきましても、引き続き自動車関連産業や工作機械産業向けを中心に各ユーザーからの需要が好調で、前中間期比増収増益を達成しました。

この結果、当中間期の連結受注高は449億56百万円（前中間期比4.2%減）、連結売上高は420億83百万円（同7.2%減）、連結経常利益は67億20百万円（同19.0%減）、連結当期純利益は39億14百万円（同12.1%減）となりました。

[各部門の概況]

A. 半導体製造装置部門

半導体製造装置部門につきましては、期の前半に少し調整があったものの、全般的には市況は堅調でありました。各ユーザーのニーズに応えるきめ細かい営業を展開しました結果、当中間期の受注高は、341億67百万円（前中間期比11.2%減）、売上高は320億5百万円（同12.8%減）となり、過去最高であった前中間期に比べ減少となりましたが、引き続き好調に推移しています。

利益面では、売上減に伴い前期比減益となりましたが、固定費削減・内製比率アップによる変動比率引き下げなどのコストダウンを推進しました結果、堅調に41億90百万円（同32.3%減）の営業利益を計上することができました。

(地域別の状況)

地域別に見ますと、前中間期比では国内外とも減少していますが、前年度下期比では韓国・台湾・中国の東アジア及び国内を中心に、売上が回復しています。

(製品別の状況)

- (a) ウェーハプロ - ビングマシンにつきましては、300mm ウェーハ対応機への需要が旺盛で、300mm 対応の「UF3000」が前期比大きく伸びました。「UF3000」は、300mm 対応の第三代機で、システム LSI などの多品種少量生産から、メモリなどの大量生産まで、あらゆるデバイスメーカーのニーズをカバーするフルオートタイプの超高性能プロ - ビングマシンとして、お客様から高い支持を得ています。
200mm 対応機の「UF200」シリーズも堅調に推移しており、当社はウェーハプロ - ビングマシンの No.1 プレーヤーとして業績を着実に伸ばしています。
- (b) ウェーハダイシングマシンにつきましても、300mm 対応の「A - WD - 300T」および 200mm 対応の「A - WD - 200T」は生産性の高いマシンとして引き続きお客様からの評判が高く、堅調に推移していますが、この分野の設備投資は繰延など慎重姿勢があったため、前中間期比減収・減益を余儀なくされました。
昨年度より販売の、ブレードを使わない完全ドライプロセスの新型レーザダイシング装置「MAHOH DICING Machine」は、ユーザーから性能および生産性を高く評価されており、MEMS 向けや薄物ウェーハ向けを主として今後の拡販が期待できます。
- (c) ウェーハ外観検査装置では、「WIN - WIN50」の強みである、低い Cost of Ownership や高い検出率などが高く評価され、既存ユーザーからリピートオーダーを頂くとともに、新規ユーザーも増えています。また、新たに高いスループットのシリーズを加えて、多岐にわたるユーザーニーズに応えており、マーケットシェアを着実に伸ばしています。
- (d) ポリッシュ・グライндаは、ウェーハの薄片化とダメージ除去を 1 台で実現している他に追随を許さない当社独自の製品で、ウェーハ薄片化市場におけるデファクトスタンダードとなりました。当期は、300mm 対応機である「PG300」の需要が急拡大し、受注・売上とも前中間期比倍増し、過去最高となっています。
- (e) また、CMP 装置につきましても、当社の「ChaMP」シリーズのコンセプトや構造の優位性がお客様に浸透し高く評価され、今後一層の成長が期待されます。

B. 計測機器部門

計測機器部門につきましては、活況が続く自動車業界や工作機械業界などのユーザーニーズを確実に受注に取込む営業努力により、売상을伸ばすことができ、当中間期の受注高は 107 億 88 百万円（前中間期比 27.8%増）、売上高は 100 億 77 百万円（同 16.5%増）と大きく伸長し、半期ベースで既往ピークを更新しました。売上高は 2003 年度下期以降、半期ベースで 4 期連続過去最高を更新しています。

生産面でもコストダウンに注力し、営業利益も 24 億 3 百万円（同 22.3%増）と増益を達成しました。

(地域別の状況)

地域別に見ますと、国内を中心に、前中間期比大きく伸長しています。

(製品別の状況)

(a) 汎用計測機器では、カールツァイス社の解析・制御技術と当社の高剛性設計技術を融合した三次元座標測定機「ザイザックス SVA」シリーズがお客様のニーズに合った製品として高評価を受け好調です。加えて、昨年販売開始したスキャニング高精度保証の「ザイザックス SVA fusion」や今年市場投入したカールツァイス社の新製品インライン三次元「ゲージ MAX」を中心に大きく伸びました。

また、リニアモータ採用で世界最高精度と低振動を実現した表面粗さ形状測定機「サーフコムシリーズ」は、「SARFCOM 5000 DX」を市場投入し、順調に売上が拡大しています。

高精度で高評価を得ている真円度測定機「ロンコムシリーズ」では、「RONDCOM 54/44」や「RONDCOM 72/75」の大型機シリーズの売上也好調で、製品のラインアップが充実し、堅調な売上増につながっています。

(b) 自動計測機器は、自動車産業の設備投資が活発であったことを反映し、自動車の部品生産ライン等で使用される「パルコムシリーズ」などが好調でありました。また「ATC 振れ測定システム」も多くのユーザーに標準採用されています。また、ワイヤレス接続が可能なエレクトロコラムゲージとハンドゲージ「ELCOM 8 for wireless」の販売も好調です。

[利益配分について]

当中間期の配当につきましては、前述の利益配分の基本方針から、一株当たり 5 円増配し、当初予定どおり、一株当たり 20 円とすることといたしました。

次期の見通し

[業績全般及び各部門の概況]

A. 半導体製造装置部門

今後の半導体市場は、中期的にはデジタル・コンシューマ機器の需要増加に加え、パソコンの堅調な需要や車載デバイスの伸長などにより堅調な伸びが予想されます。半導体メーカーの設備投資も、300mm ウェーハ関連投資の本格化などにより、拡大が期待されます。

このような状況下、当社は、2005 年度下期の半導体製造装置の経営環境について、マーケットシェアの高い、ウェーハプロービングマシン、ウェーハダイシングマシンなどの既存製品については、短納期発注が一般化し予想を立てにくいこともあり、慎重に予想しています。

しかし、ウェーハ外観検査装置、ポリッシュ・グラインダ、CMP 装置の新規参入製品については、微細化・薄片化などの技術革新に基づく設備投資が旺盛で、売上伸長が期待でき、通期では 2004 年度を上回ることができると予想し、半導体製造装置部門の売上高は、下期 365 億円、通期 685 億円（前年度比 2.7%増）と過去最高となる見込です。

B. 計測機器部門

計測機器部門につきましては、2005 年度下期も引き続き国内外において、自動車関連をはじめ工作機械、ベアリングなどの各ユーザーから強い需要が見込まれ、好調に推移すると予想しています。

かかる状況下、お客様のニーズを的確に把握し受注に繋げることにより、2005 年度売上高は下期 104 億円、通期 205 億円（前年度比 13.4%増）と過去最高を予定しています。

以上のような予測の下、2005 年度下期の連結売上高は 469 億円と予定し、2005 年度通期の連結売上高は、2 年連続で既往ピークの更新となる 890 億円（前期比 5.0%増）を予想しています。

利益につきましては、通期の連結経常利益を 140 億円（同 8.6%増）と見込み、連結当期純利益は過去最高となる 77 億円（同 72.7%増）と予想しております。

[利益配分について]

期末配当金につきましては、上記業績見通し及び前述の利益配分に関する基本方針に従い、安定的な配当を継続することとし、一株当たり 20 円（中間配当金と合わせ通期では、一株当たり 10 円増配し、一株当たり 40 円）を予定しております。

(2) 財政状態

当中間期末における現金及び現金同等物は、前期末より 11 億円減少し、107 億円となりました。当中間期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは 11 億円の収入となりました。これは主に税引前利益（68 億円）減価償却費（13 億円）売上債権の増加（12 億円）たな卸資産の増加（11 億円）および仕入債務の増加（11 億円）法人税等の支払（26 億円）などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは 46 億円の支出となりました。これは設備投資支出（35 億円）長期定期性預金の預入（10 億円）などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、23 億円の収入となりました。これは主に、短期借入金の増加（29 億円）および配当金の支払（5 億円）などによるものであります。

当中間期の営業キャッシュ・フローは、11 億円のプラスとなりました。今後も新製品の売上拡大や利益計上などにより、営業キャッシュ・フローのプラスが見込まれ、より良い財務状況を構築できる見込です。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りであります。

	平成 16 年 9 月期	平成 17 年 3 月期	平成 17 年 9 月期
自己資本比率 (%)	34.1	32.7	35.2
時価ベースの自己資本比率 (%)	118.2	138.5	184.2
債務償還年数 (年)	2.7	4.4	15.4
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	42.5	29.4	26.6

自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

注 1．指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

注 2．株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式総数により算出しています。

注 3．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

将来の事象に係る記述に関する注意

この決算短信に記載されている業績見通しに関する記載内容につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、ならびに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

4. 比較中間連結貸借対照表

前中間期（平成 16 年 9 月 30 日現在）

当中間期（平成 17 年 9 月 30 日現在）

前 期（平成 17 年 3 月 31 日現在）

（単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示）

科 目	前中間期	当中間期	前 期	科 目	前中間期	当中間期	前 期
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	75,001	74,832	73,752	流 動 負 債	34,014	34,383	34,941
現金及び預金	10,177	10,773	11,866	支払手形及び買掛金	23,233	19,205	17,809
受取手形及び売掛金	30,248	33,433	32,105	短期借入金	1,365	3,453	458
たな卸資産	33,407	29,353	28,134	一年以内返済予定 長期借入金	3,731	4,042	4,160
未収消費税等	377	237	539	一年以内償還予定社債	200	450	450
繰延税金資産	373	579	753	未払法人税等	1,323	2,715	2,890
その他流動資産	468	507	412	賞与引当金	697	900	951
貸倒引当金	50	53	60	その他流動負債	3,462	3,615	8,221
固 定 資 産	23,309	29,603	27,240	固 定 負 債	28,466	30,596	30,538
（有形固定資産）	（12,600）	（15,069）	（13,885）	社 債	19,750	19,300	19,400
建物及び構築物	5,140	7,347	7,528	転換社債	51	51	51
機械装置及び運搬具	2,919	3,577	1,982	長期借入金	4,491	6,839	6,753
工具器具備品	902	917	927	退職給付引当金	3,521	3,691	3,610
土地	2,917	2,910	2,917	役員退職慰労引当金	604	669	675
建設仮勘定	719	317	529	繰延税金負債	47	46	46
（無形固定資産）	（3,146）	（2,111）	（2,581）	負 債 合 計	62,480	64,980	65,479
ソフトウェア	2,673	1,828	2,263				
その他無形固定資産	472	282	317	少 数 株 主 持 分	2,299	2,700	2,510
（投資その他の資産）	（7,562）	（12,423）	（10,773）				
投資有価証券	3,449	4,323	3,524	資 本 の 部			
長期貸付金	454	333	350	資 本 金	7,392	7,392	7,392
繰延税金資産	3,057	6,131	6,331	資 本 剰 余 金	12,017	12,017	12,017
長期性預金	-	1,000	-	利 益 剰 余 金	14,153	16,938	13,596
その他の投資	614	645	578	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	41	436	70
その他の資産				為替換算調整勘定	16	39	9
貸倒引当金	13	10	10	自 己 株 式	58	68	63
繰 延 資 産	0	0	0	資 本 合 計	33,530	36,755	33,003
社債発行差金	0	0	0	負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	98,311	104,436	100,993
資 産 合 計	98,311	104,436	100,993				

5 . 比較中間連結損益計算書

前中間期（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 9 月 30 日）

当中間期（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日）

前 期（平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日）（単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示）

科 目	前 中 間 期	当 中 間 期	前 期
売 上 高	45,340	42,083	84,750
売 上 原 価	30,847	29,207	59,344
売 上 総 利 益	14,493	12,875	25,405
販売費及び一般管理費	(6,336)	(6,282)	(12,354)
販 売 費	4,850	4,693	9,516
一 般 管 理 費	1,485	1,588	2,837
営 業 利 益	8,157	6,593	13,051
営業外収益	(323)	(434)	(278)
受取利息及び受取配当金	31	37	51
そ の 他	292	397	226
営業外費用	(185)	(308)	(443)
支 払 利 息	142	139	293
そ の 他	43	168	150
経 常 利 益	8,295	6,720	12,885
特別利益	(184)	(114)	(523)
投資有価証券売却益	68	76	358
そ の 他	115	38	165
特別損失	(583)	(8)	(7,007)
たな卸資産評価損及び廃却損	574	-	5,861
固 定 資 産 除 却 損	-	-	854
そ の 他	9	8	291
税金等調整前中間（当期）純利益	7,895	6,827	6,401
法人税、住民税及び事業税	1,207	2,543	3,187
法人税等調整額	2,001	145	1,688
少数株主持分利益	232	223	444
中 間（当 期）純 利 益	4,454	3,914	4,459

6. 比較中間連結剰余金計算書

前中間期（平成16年4月1日～平成16年9月30日）

当中間期（平成17年4月1日～平成17年9月30日）

前期（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

（単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示）

科 目	前 中 間 期	当 中 間 期	前 期
（資本剰余金の部）			
資本剰余金期首残高	11,806	12,017	11,806
資本剰余金増加高	211	-	211
1. 新株引受権の権利行使による増加高	211	-	211
資本剰余金減少高	-	-	-
資本剰余金中間期末（期末）残高	12,017	12,017	12,017
（利益剰余金の部）			
利益剰余金期首残高	10,273	13,596	10,273
利益剰余金増加高	4,454	3,914	4,459
1. 中間（当期）純利益	4,454	3,914	4,459
利益剰余金減少高	574	572	1,136
1. 配当金	560	562	1,122
2. 取締役賞与金	14	9	14
利益剰余金中間期末（期末）残高	14,153	16,938	13,596

7. 比較中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間期（平成16年4月1日～平成16年9月30日）

当中間期（平成17年4月1日～平成17年9月30日）

前 期（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

（単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示）

勘定科目	前中間期	当中間期	前 期
営業活動キャッシュ・フロー			
税金等調整前中間純利益又は当期純利益	7,895	6,827	6,401
減価償却費	1,470	1,338	2,732
連結調整勘定償却額	40	-	160
退職給付引当金の増加額	23	80	112
役員退職慰労引当金の増減額	47	6	118
貸倒引当金の増減額	9	6	16
受取利息及び受取配当金	31	37	51
支払利息	142	139	293
有形固定資産除却・売却損益	14	150	936
投資有価証券・ゴルフ会員権評価損	9	-	2
投資有価証券売却益	68	76	358
売上債権の増加額	3,493	1,216	5,427
たな卸資産の増減額	4,105	1,178	1,006
仕入債務の増加額	5,304	1,183	37
取締役賞与の支払額	14	9	14
その他営業活動による収入又は支出	817	3,328	2,532
小 計	6,397	3,858	8,499
利息及び配当金の受取額	31	37	51
利息の支払額	149	146	291
法人税等の支払額	724	2,641	1,201
営業活動キャッシュフロー	5,554	1,108	7,058
投資活動キャッシュ・フロー			
定期預金の預入	11	1,021	21
定期預金の払出	10	11	20
投資有価証券の取得	222	194	412
投資有価証券の売却	116	85	579
関係会社出資金	21	-	46
有形・無形固定資産の取得	717	3,555	1,998
有形固定資産の売却	62	35	78
貸付金の実行	376	-	382
貸付金の回収	303	16	413
投資活動キャッシュフロー	857	4,622	1,769
財務活動キャッシュ・フロー			
短期借入金の増減額	4,178	2,994	5,085
長期借入金の実行	700	2,500	5,300
長期借入金の返済	3,084	2,532	4,994
社債の償還	100	100	200
新株引受権の権利行使	383	70	383
配当金の支払	560	562	1,122
その他財務活動による支出	8	5	13
財務活動キャッシュフロー	6,847	2,365	5,732
現金・現金同等物 換算差額	58	46	39
現金・現金同等物 減少額	2,092	1,101	403
現金・現金同等物 期首残高	12,242	11,838	12,242
現金・現金同等物 期末残高	10,149	10,737	11,838

8 . 中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

1 . 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社(8社)

(株)東精エンジニアリング、(株)トーセシステムズ、(株)アクレーテック・マイクロテクノロジー、(株)アクレーテック・クリエイト、(株)アクレーテック・ファイナンス、(株)リープル、ACCRETECH USA, INC.、ACCRETECH (EUROPE) GmbH

(2) 非連結子会社(9社)

(株)東精ボックス、ACCRETECH(MALAYSIA)SDN,BHD.、ACCRETECH(ISRAEL)LTD.、ACCRETECH(SINGAPORE)PTE LTD.、ACCRETECH MICRO TECHNOLOGIES KOREA CO.,LTD、東精精密設備(上海)有限公司、東精計量儀(平湖)有限公司、TOSEI KOREA CO.,LTD、TOSEI(THAILAND) CO.,LTD

連結の範囲から除いた理由は、上記9社いずれも小規模会社であり、合計の総資産・売上高・中間純損益及び利益剰余金の金額がいずれも僅少であり、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないためであります。

2 . 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社9社及び関連会社三門峡中原精密有限責任公司については、それぞれ中間連結純損益及び連結利益剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、これらの会社に対する投資については、持分法を適用せず原価法により評価しております。

3 . 連結子会社の中間決算日に関する事項

連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。

4 . 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの……中間連結会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法による原価法により算定しています。)

時価のないもの……移動平均法による原価法を採用しております。

(ロ) デリバティブ

時価法によっております。

(ハ) たな卸資産

親会社及び国内連結子会社は、商品・製品・材料及び貯蔵品については、先入先出法による原価法、仕掛品については、個別法による原価法であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

親会社及び国内連結子会社は、定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物付属設備は除く)については、定額法によっております。

(ロ) 無形固定資産

市場販売目的のソフトウェアは、見込販売数量に基づく方法又は残存有効期間に基づく定額法によっており、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。その他の無形固定資産は、定額法であります。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(ロ) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。

(ハ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生翌連結会計年度より費用処理しております。

(二) 役員退職慰労引当金

役員の退任時に支出が予想される役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間連結会計期間末支払見込額を計上しております。なお、親会社は当連結会計年度より役員退職慰労金制度を廃止しており、取締役分については平成 17 年 3 月末日、監査役分については平成 17 年 6 月末日時点の支払見込額をもって引当金計上額としております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から 3 ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

6. 固定資産の減損に係る会計基準

当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針 第 6 号 平成 15 年 10 月 31 日)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。

9. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

当中間期(平成17年4月1日～平成17年9月30日)

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造 装置関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売上高及び営業損益					
(1)外部顧客に対する売上高	32,005	10,077	42,083	-	42,083
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	(-)	-
計	32,005	10,077	42,083	(-)	42,083
営業費用	27,815	7,674	35,489	(-)	35,489
営業利益	4,190	2,403	6,593	(-)	6,593

前中間期(平成16年4月1日～平成16年9月30日)

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造 装置関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売上高及び営業損益					
(1)外部顧客に対する売上高	36,691	8,649	45,340	-	45,340
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	(-)	-
計	36,691	8,649	45,340	(-)	45,340
営業費用	30,498	6,684	37,183	(-)	37,183
営業利益	6,192	1,964	8,157	(-)	8,157

前期(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造 装置関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売上高及び営業損益					
(1)外部顧客に対する売上高	66,669	18,081	84,750	-	84,750
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	(-)	-
計	66,669	18,081	84,750	(-)	84,750
営業費用	57,884	13,814	71,698	(-)	71,698
営業利益	8,784	4,267	13,051	(-)	13,051

(2) 所在地別セグメント情報

当中間期 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 9 月 30 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消却又は全社	連 結
売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する売上高	36,155	3,430	2,498	42,083	-	42,083
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	3,799	-	-	3,799	(3,799)	-
計	39,954	3,430	2,498	45,882	(3,799)	42,083
営 業 費 用	33,589	3,417	2,230	39,236	(3,747)	35,489
営 業 利 益	6,365	12	267	6,645	(52)	6,593

前中間期 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消却又は全社	連 結
売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する売上高	37,664	4,552	3,123	45,340	-	45,340
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	4,513	-	-	4,513	(4,513)	-
計	42,178	4,552	3,123	49,854	(4,513)	45,340
営 業 費 用	34,423	4,516	2,809	41,749	(4,566)	37,183
営 業 利 益	7,755	35	314	8,105	52	8,157

前 期 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消却又は全社	連 結
売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する売上高	69,846	9,226	5,677	84,750	-	84,750
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	9,277	-	-	9,277	(9,277)	-
計	79,123	9,226	5,677	94,027	(9,277)	84,750
営 業 費 用	66,386	9,199	5,478	81,064	(9,365)	71,698
営 業 利 益	12,737	27	199	12,963	88	13,051

(3) 海外売上高

当中間期 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 9 月 30 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
海外売上高	14,225	3,192	2,065	1,651	21,134
連結売上高					42,083
連結売上高に占める海外売上高	33.8%	7.6%	4.9%	3.9%	50.2%

前中間期 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
海外売上高	14,429	4,771	3,112	1,943	24,257
連結売上高					45,340
連結売上高に占める海外売上高	31.8%	10.5%	6.9%	4.3%	53.5%

前 期 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
海外売上高	25,048	8,166	5,706	3,938	42,860
連結売上高					84,750
連結売上高に占める海外売上高	29.6%	9.6%	6.7%	4.7%	50.6%

10. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

事業の種類別 セグメントの名称	前中間期	当中間期	前期
	自平成16年4月1日 至平成16年9月30日	自平成17年4月1日 至平成17年9月30日	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
半導体製造装置	37,830	31,019	67,708
計測機器	8,645	10,318	18,054
合計	46,476	41,337	85,763

(注) 金額表示は販売価額(消費税抜き)によっております。

(2) 受注実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

事業の種類別 セグメントの名称	前中間期		当中間期		前期	
	自平成16年4月1日 至平成16年9月30日		自平成17年4月1日 至平成17年9月30日		自平成16年4月1日 至平成17年3月31日	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半導体製造装置	38,488	16,617	34,167	15,562	65,248	13,400
計測機器	8,440	3,356	10,788	4,402	18,207	3,691
合計	46,929	19,974	44,956	19,964	83,456	17,091

(注) 金額表示は販売価額(消費税抜き)によっております。

(3) 販売実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

事業の種類別 セグメントの名称	前中間期	当中間期	前期
	自平成16年4月1日 至平成16年9月30日	自平成17年4月1日 至平成17年9月30日	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
半導体製造装置	36,691	32,005	66,669
計測機器	8,649	10,077	18,081
合計	45,340	42,083	84,750

(注) 金額表示は販売価額(消費税抜き)によっております。

1 1 . 有価証券の時価等

(1) 有価証券の時価等

時価のある有価証券

(単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示)

区 分	前 中 間 期 (平成16年9月30日現在)			当 中 間 期 (平成17年9月30日現在)			前 期 (平成17年3月31日現在)		
	取得原価	中間連結 貸借対照 表計上額	差 額	取得原価	中間連結 貸借対照 表計上額	差 額	取得原価	連結貸借 対 照 表 計 上 額	差 額
その他の有価証券									
(a) 株 式	2,443	2,531	87	2,744	3,482	738	2,591	2,715	124
計	2,443	2,531	87	2,744	3,482	738	2,591	2,715	124

時価のない有価証券

(単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示)

区 分	前 中 間 期 (平成16年9月30日現在)	当 中 間 期 (平成17年9月30日現在)	前 期 (平成17年3月31日現在)
	中間連結貸借対照表計上額	中間連結貸借対照表計上額	連結貸借対照表計上額
その他の有価証券			
(a)非上場株式	918	841	808
計	918	841	808

1 2 . 関連当事者との取引

当中間連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

該当事項はありません。

1 3 . 重要な後発事象

当中間連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

当社は、平成17年5月6日付締結の株式交換契約に基づき子会社(株)東精エンジニアリングを平成17年10月1日付で完全子会社といたしました。

なお、この株式交換の結果、発行済株式数、連結調整勘定、少数株主持分、資本剰余金が以下のとおり増加または減少しております。

- ・発行済株式数 1,711,203 株の増加
- ・連結調整勘定 3,327,483 千円の増加
- ・少数株主持分 2,610,585 千円の減少
- ・資本剰余金 6,218,511 千円の増加